別表第十一の三の三（第六十条、第六十八条関係）

検定職種	等級
（略）	（略）
非接触除去加工	（略）
（略）	（略）
電気機器組立て	（略）
シーケンス制御	特級、一級、二級及び三級
半導体製品製造	（略）
（略）	（略）
（削る）	（削る）
（略）	（略）

別表第十一の四（第六十一条関係）

検定職種	等級
（略）	（略）
放電加工	（略）
（略）	（略）
電気機器組立て	（略）
（新設）	（新設）
半導体製品製造	（略）
（略）	（略）
陶磁器製造	一級及び二級
（略）	（略）

別表第十一の四の二（第六十二条の二関係）

検定職種	実施方法
（略）	（略）
非接触除去加工	（略）
（略）	（略）
電気機器組立て	（略）
シーケンス制御	一　製作等作業試験 二　計画立案等作業試験
半導体製品製造	（略）
（略）	（略）

別表第十一の三の三（第六十条、第六十八条関係）

検定職種	等級
（略）	（略）
放電加工	（略）
（略）	（略）
電気機器組立て	（略）
（新設）	（新設）
半導体製品製造	（略）
（略）	（略）
陶磁器製造	一級及び二級
（略）	（略）

別表第十一の四（第六十一条関係）

検定職種	等級
（略）	（略）
非接触除去加工	（略）
（略）	（略）
電気機器組立て	（略）
シーケンス制御	特級、一級、二級及び三級
半導体製品製造	（略）
（略）	（略）
（削る）	（削る）
（略）	（略）

別表第十一の四の二（第六十二条の二関係）

検定職種	実施方法
（略）	（略）
放電加工	（略）
（略）	（略）
電気機器組立て	（略）
（新設）	（新設）
半導体製品製造	（略）
（略）	（略）